

中信证券股份有限公司
关于中微半导体（深圳）股份有限公司
2024 年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“中微半导”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2025 年 4 月 8 日和 4 月 14 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

（2）查阅公司 2024 年度内部控制评价报告、2024 年度内部控制审计报告等文件；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2024 年度审计报告、关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明；

(4) 查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

(5) 对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《2023 年度业绩预告》，预计 2023 年归母净利润为-2,780 万元；于 2024 年 2 月 24 日披露了《2023 年度业绩快报公告》，初步核算公司 2023 年归母净利润为-2,783.43 万元。2024 年 4 月 9 日，公司披露了《2023 年度业绩快报更正公告》，说明由于存货跌价准备计提不准确及将对损益产生持续影响的政府补助划分为非经常性损益，公司对前期业绩快报中的利润数据进行了修正，修正后的归母净利润为-2,182.43 万元。2024 年 4 月 27 日，公司披露了《2023 年年度报告》，2023 年归母净利润为-2,194.85 万元。据此测算，公司业绩预告预计的归母净利润与实际数据差异幅度为 21.04%，业绩快报修正前预计的归母净利润与实际数据差异幅度为 21.15%，公司 2023 年度业绩预告和业绩快报披露不准确。公司因上述 2023 年度业绩预告信息披露不准确收到了深圳证监局监管关注函及上海证券交易所口头警示。

针对该问题，保荐人已督促公司及相关负责人加强对证券法律法规的学习和培训，勤勉履行职责，以保证披露信息的真实、准确、完整，并对会计核算薄弱环节进行全面梳理和整改，夯实财务会计基础，提升信息披露质量。

三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）核心竞争力风险

公司所处的集成电路行业为技术密集型企业。公司研发水平的高低直接影响公司的竞争能力。公司自上市以来，在业务快速增长的基础上不断增加研发投入，新招聘大量优秀高端人才，在保障现有产品性能及功能优化的同时大力增加新产品的研发，努力缩短新产品的研发成果转化周期。

1、产品研发风险

公司作为芯片设计公司，为适应市场新需求和新变化，坚持以研发和技术创新为引领。由于芯片设计的技术要求高、工艺复杂，且流片成本较高，若公司产品研发失败，存在前期投入资金无法收回的风险。

公司正在从事的主要研发项目包括大家电主控芯片研发项目、车规级 MCU 系列芯片研发项目、基于 55/40 纳米制程的芯片研发项目、下一代电机系列芯片项目、IGBT 及功率器件研发项目和动力电池 BMSSoC 研发项目等。上述新产品研发的开发周期较长、资金投入较大，若公司在产品规划阶段未能及时跟踪市场需求走向，或未能维持研发人员的稳定性及研发体系的稳健运作，或在研项目的下游产品技术路径、应用场景等未获市场认可，将对公司未来业绩造成一定影响；此外，若公司研发投入未能及时产业化、技术人才储备无法适应行业的技术形势，导致公司市场竞争中处于落后地位，无法及时、有效地推出满足客户及市场需求的新产品，可能会对公司市场份额和核心竞争力产生一定影响。

2、研发人才流失及技术泄密风险

集成电路设计行业属于技术密集型企业，行业内企业的核心竞争力体现在技术储备及研发能力上，对技术人员的依赖程度较高。当前公司多项产品和技术处于研发阶段，在新技术开发过程中，客观上也存在因人才流失而造成技术泄密的风险；针对人才流失风险，公司建立了包括薪酬、绩效及股权激励在内的多渠道激励模式，不断吸引行业内优秀人才，建立技术领先、人员稳定的多层次人才梯队。

另外，公司核心技术涵盖产品研发的全流程，公司的 Fabless 经营模式决定

了公司需向委托加工商或合作伙伴提供相关芯片的技术资料，如因个别人员的工作疏漏、主观对外泄露或供应商管控不当等原因导致公司核心技术泄密，可能对公司产品研发进展、产品质量等核心竞争力的产生一定的不良影响，进而影响公司业务发展和经营业绩。

（二）经营风险

1、供应商集中度较高风险

公司采取 Fabless 模式，将芯片生产及主要的封测等工序交给外协厂商负责。公司存在因外协工厂生产排期导致供应量不足、供应延期或外协工厂生产工艺存在不符合公司要求的潜在风险。此外，由于行业特性，晶圆制造和封装测试均为资本及技术密集型产业，国内主要由大型国企或大型上市公司投资运营，因此相关行业集中度较高，是行业普遍现象。如果公司供应商发生不可抗力的突发事件，或因集成电路市场需求旺盛持续出现产能紧张等因素，晶圆代工和封装测试产能可能无法满足需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

2、原材料及封装加工价格波动风险

公司主营业务成本主要由晶圆、封装及测试成本构成，晶圆采购成本和芯片封装测试成本变动会直接影响公司的营业成本，进而影响毛利率和净利润。晶圆是公司产品的主要原材料，由于晶圆加工对技术水平及资金规模要求极高，全球范围内知名晶圆制造厂数量较少。如果未来因集成电路市场需求量旺盛，公司向其采购晶圆的价格出现大幅上涨，将对公司经营业绩产生不利影响。

（三）财务风险

1、收入波动风险

2024 年度，公司实现营业收入 91,165.47 万元，较上年同期增长 27.76%。公司终端客户多集中于消费电子、家电领域，若大客户需求减少或行业景气度下行，将直接冲击营收的稳定性。公司必须继续拓展工业控制、汽车等市场领域，推出新产品抢占细分市场份额。

2、毛利率波动风险

2023 年度、2024 年度公司主营业务毛利率分别为 17.04%和 29.79%，2024 年度同比增长 12.75 个百分点。公司所处行业集中度高，行业龙头公司容易凭借规模和技术、产品链高完整度等优势挤占其他厂商利润空间。随着国产替代逐步进入深水区，在产品差异化日益缩小的趋势下，上下游合作厂商可能因执行纵向一体化战略进一步加剧现有市场竞争烈度。公司必须根据市场需求不断进行产品的迭代升级和创新，通过新产品稳固现有市场份额和利润空间。

3、存货跌价风险

公司 2024 年末存货跌价准备余额为 6,289.74 万元，同比下降 10.02%。公司根据已有客户订单需求以及对市场未来需求的预测情况制定采购和生产计划。若市场需求环境发生变化、市场竞争加剧或公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理、合理控制存货规模，可能导致产品滞销、存货积压，从而存货跌价风险提高，将对公司经营业绩产生不利影响。

4、应收账款的坏账风险

2024 年应收账款金额同比增长 2.80%，随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额可能逐步增加。如果未来公司应收账款管理不当或者由于某些客户因经营出现问题导致公司无法及时回收货款，将增加公司的经营风险。

5、税收优惠政策变动风险

根据财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告 2020 年第 45 号），国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，后续年度减按 10% 的税率征收企业所得税。由于研发投入加大，公司预计 2024 年度能够达到国家鼓励的重点集成电路设计企业指标，减按 10% 的税率征收企业所得税计提。

若未来上述税收优惠政策发生调整，或者公司不再满足享受以上税收优惠政策的条件，将对公司的经营业绩产生一定影响。

6、非经常性损益变动风险

公司 2024 年非经常性损益金额 4,565.92 万元，较上年度减少 374.47 万元，主要来源于公司持有大额资金理财收益、政府项目补贴和电科芯片（600877.SH）的股票等。随着二级市场波动，公司持有电科芯片带来的非经常性收益具有不确定性；随着国家通过较为宽松的货币政策刺激经济，理财收益存在下降的风险；随着国产替代进程持续推进并显有成效，行业补贴政策力度和稳定性后续将面临不确定性，政府补贴有变化的风险。

7、汇率波动风险

公司的晶圆采购主要以美元报价和结算。虽然公司在业务开展时已考虑了合同或订单订立及款项收付之间汇率可能产生的波动，但随着国内外政治、经济环境的变化，汇率变动仍存在较大的不确定性，未来若人民币与美元汇率发生大幅波动，将对公司业绩造成一定影响。

（四）行业风险

公司的业务扩张主要受益于汽车电子、工业、智能家居、高端消费等应用领域的终端产品市场的迅速增长。下游应用市场种类繁多，市场需求变化明显，但单个市场需求相对有限。如果未来下游应用发展速度放缓，整体市场增长停滞，或者公司无法快速挖掘新产品应用需求，及时推出适用产品以获取新兴市场份额，可能会面临业绩波动的风险。

（五）宏观环境风险

1、宏观经济和行业波动风险

半导体行业是面临全球化的竞争与合作并得到国家政策大力支持的行业，受到国内外宏观经济、行业法规和贸易政策等宏观环境因素的影响。近年来，全球宏观经济表现平稳，国内经济稳中有升，国家也出台了相关的政策法规大力支持半导体行业的发展。未来，如果国内外宏观环境因素发生不利变化，可能会对公司经营带来不利影响。

2、经营受国际贸易摩擦影响的风险

近年来，国际政治、经济形势日益复杂，随着国际贸易摩擦的加剧，美国商

务部已将多家中国企业和机构列入美国出口管制的“实体清单”，并且不断扩大“实体清单”名单，加强对“实体清单”的限制。公司的客户主要以境内企业为主，上述外部因素可能导致公司为若干客户提供芯片产品和服务受到限制。公司的部分供应商无可避免地使用了美国设备或技术，可能导致其为公司供货或提供服务受到限制。一旦国际贸易摩擦的状况持续或进一步加剧，公司可能面临经营受限、订单减少或供应商无法供货等局面，若公司未能及时成功拓展新客户或供应商，极端情况下可能出现公司的营业收入下滑，令公司的经营业绩出现较大下降。因此，公司存在生产经营受国际贸易摩擦影响的风险。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	91,165.47	71,356.97	27.76
归属于上市公司股东的净利润	13,683.39	-2,194.85	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,117.47	-7,135.23	不适用
经营活动产生的现金流量净额	31,285.00	2,071.34	1,410.38
主要会计数据	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	299,336.99	297,163.84	0.73
总资产	330,930.42	315,108.00	5.02
主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.34	-0.05	不适用
稀释每股收益 (元 / 股)	0.34	-0.05	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.23	-0.18	不适用

加权平均净资产收益率 (%)	4.59	-0.71	增加5.30个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.06	-2.31	增加5.37个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	13.99	16.88	减少2.89个百分点

1、报告期内公司实现营业收入 91,165.47 万元，较上年同期增长 27.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,683.39 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,117.47 万元，实现利润扭亏为盈。

主要原因如下：一是公司下游客户所处领域的需求回暖，带动对集成电路需求的增加，新经济、新业态的出现扩大了公司产品应用领域，致使公司芯片年出货量持续增长、累创新高，推动营业收入大幅增长；二是公司持续高强度投入研发，新产品推出不断丰富产品系列，满足更多应用场景，如车规级产品持续增多，得到多家行业知名客户的采用，出货量增长迅速；同时加速已有产品更新迭代，通过资源精准定义、整合外围电子元器件、提高集成度、优化设计提高性能等提高可售产品的综合竞争力，公司产品的品牌影响力、市占率持续提升；三是公司有效加强了无刷电机控制及驱动芯片的方案开发和服务能力，提高客户满意程度，新客户、新项目持续增加，在人工智能服务器、机器人方面的应用实现突破，无刷电机控制及驱动芯片收入同比接近翻番；四是公司坚持以客户为中心，推行积极的销售策略，高成本库存产品有效消化，新入库产品摊薄在售产品成本，产品毛利率成功回升，公司毛利有效增长。

2、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 31,285.00 万元，较上年度大幅增加，主要原因是公司销售回款额增加和采购支出减少。

3、报告期内研发投入营收占比为 13.99%，较上年度下降 2.89 个百分点，主要原因是营收增幅大于研发投入增幅。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

公司在芯片设计领域深耕 20 余年，不断拓展自主设计能力，积累的自主 IP

超过 1,000 个，具有技术全面、产品线丰富、人才团队建设完善、供应链保障度高的特点。

1、技术布局全、应用领域广

公司围绕智能控制器所需芯片和算法进行技术与产品布局，经过 20 余年的技术积累，具备主流系列 MCU、高精度模拟、功率驱动、功率器件、无线射频、高性能触摸和底层核心算法的设计能力，掌握各类自有 IP 众多；产品在 40 纳米至 180 纳米 CMOS 工艺、90 纳米至 350 纳米 BCD、高压 700V 驱动、双极、SGTMOS、IGBT 等工艺制程上投产，可供销售产品众多，可满足多个细分领域不同客户对芯片功能、资源、性价比的差异化需求。全面的技术能力，使公司成为平台型的芯片设计企业，实现了芯片的结构化和模块化开发，针对不同细分领域可快速推出具有竞争优势的产品，还可为客户提供差异化、定制化服务。产品广泛应用于家电、消费类、物联网、医疗电子、工业控制、汽车电子等领域，具有应用领域广的优势。

2、整合能力强、集成程度高

公司始终追求集成电路的本质，通过全面的设计技术（数字、模拟、功率器件设计能力）提升外围电子的整合能力、提高产品集成度，通过提供更多的算力、存储、集成模拟功能、管脚组合和封装形式选择，不仅可以支持嵌入式应用开发多样化的特点，而且可以为客户提供更具性价比方案，提高产品性能、降低综合成本，提升产品综合竞争力。以公司电机 SoC 芯片为例，与传统方案相比，公司单芯片集成了 MCU、LDO、预驱、3 颗（P+N）MOS，一颗芯片实现了传统方案 6 颗芯片的功能。

3、团队协同好、平台型开发

IC 设计行业是知识密集型行业，企业发展的关键因素是人才。公司结合不同城市的地域特点、人才储备优势和贴近市场需求进行研发团队的布局，并于 2018 年在成都购置土地建造 22,000 平方米的研发中心，形成以成都为研发中心，以中山、重庆、北京、上海、新加坡等技术团队为支撑的“一个中心、多点支撑”的技术布局；团队分别为 IP 设计部、数字产品部、模拟产品部和功率器件部以

及应用开发支持部门。

公司以 MCU 为核心的研发平台成熟，自有 IP 众多，面向具体应用定义产品后进行模块化、结构化设计，新产品设计，开发边际成本低，开发周期短，市场导入快，新领域营收增长快。

4、合作程度深、产能保障好

公司与主要供应商稳定合作多年。2001 年与封测厂天水华天合作，携手共同成长；2005 年与晶圆厂华虹宏力合作在国内率先推出 8 位 MCU 芯片，开启全方位、全产线深度合作，2021 年在 3 个工艺实现量产，是华虹 12 寸厂 90/55nm Flash 工艺首发客户，同时也是少有的在其所有工艺全部量产客户；2013 年与晶圆厂 GLOBALFOUNDRIES 合作，并开发自有 EE 存储 IP 使用至今；同时公司寻求多晶圆厂、多工艺合作，确保晶圆产能持续增加以支撑公司快速发展；2014 年与测试厂广东利扬芯片建立芯片测试合作。长期合作所积累的信誉与共同增长的产能供给与需求，加深了公司与主要供应商之间的合作，形成了合作共赢、共同发展的战略合作伙伴关系，增强供应链合作黏性，在产能上得到较为稳定的保证。此外，公司在四川遂宁建设有产能调节型的封装测试产线，增强公司封装测试的应急能力和工程批芯片即封即测的能力，提高新产品研发验证效率。

5、产品应用经验丰富、贴近市场紧密

公司创始团队具备多年芯片应用开发经验，对终端产品应用场景具有深刻的理解。2001 年公司从芯片产业链的应用开发端走向前端的研发设计，继承了芯片应用开发基因和对应用开发认识的天然优势，善于从应用端和客户功能需求角度定义芯片、规划产品，充分认识到应用开发对芯片市场推广、更新迭代的作用，保持了强大的应用开发队伍，长期对产品进行应用研究和对客户进行技术支持，促进公司产品快速推广，降低了客户开发难度，同时在对客户服务和交流中掌握终端产品的功能需求，并将获得的信息反馈给设计前端，使公司在新产品定义或升级换代中准确响应终端需求，设计出市场定位准、资源配置恰当、性能优越、性价比高、竞争力强的芯片产品。

6、产品系列全、客户群体多

公司产品系列全，包括 8 位和 32 位 MCU、ASIC、混合信号 SoC、功率器件等，对应的应用领域广、市场空间大。公司产能在各产品线、领域中高效调节与配置，确保产能消耗和实现更大产能附加值；公司客户群体多，无大客户依赖，客户关系均衡，抗市场风险和持续盈利能力强。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	12,754.27	12,046.91	5.87
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	12,754.27	12,046.91	5.87
研发投入总额占营业收入比例（%）	13.99	16.88	减少 2.89 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

2024 年度公司研发投入金额 12,754.27 万元，较上年度增长 5.87%，主要系研发人员薪酬及研发部门房租、折旧费用的支出增加。

（二）研发进展

公司自成立以来，围绕智能控制器所需芯片和底层算法进行技术布局，经过 20 年的自主创新，形成包括高可靠性 MCU 技术、高性能触摸技术、高精度模拟技术、电机驱动芯片技术及底层算法、低功耗技术、高性能 CSPMOSFET 技术、逆导 IGBT 技术等核心技术，广泛应用于公司的各类产品。

2024 年末，公司在研项目进展如下：

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	大家电主控芯片研发项	部分型号量产；整体开	实现基于 M4 内核进行用于空调室外变频电机	国内领先	空冰洗等白电领域

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	目	发阶段	控制的 32 位高可靠性 MCU 的研发，实现进口替代		
2	车规级 MCU 系列芯片研发项目	部分型号量产；整体开发阶段	利用国产车规级 110nm 及以下制程，实现基于 M0+ 或 M4 内核车用仪表显示控制芯片等系列车规级芯片的研发，实现进口替代	国内领先	汽车电子、工业控制领域
3	物联网 SoC 及模拟芯片系列化芯片项目	部分型号量产；整体开发阶段	自研多种高性能信号采集模拟模块和芯片、高性能的信号调理模块和芯片、高性能的信号传输模块和芯片以及高性能的信号处理 SOC 芯片	国内领先	智能三表、智能穿戴等物联网领域
4	基于 55/40 纳米制程的芯片研发项目	部分型号量产；整体开发阶段	利用国产 55nm 制程带来的高速、小尺寸的工艺特性，用于指纹识别、血氧仪、血压计等的小尺寸、高算力要求的主控芯片。主频速度提升到 150MHz 以上，待机功耗控制在 5 微安以下。	国内领先	汽车电子、工业控制及消费电子领域
5	下一代电机系列芯片项目	部分型号量产；整体开发阶段	应用自研的 AGC（自动增益控制）技术和同步采样技术，动态调整电流信号放大增益，高效利用硬件的速度优势处理关键信号。支持电机转速超过 15 万转。	国内领先	工业控制、消费电子领域
6	超低功耗芯片研发项目	部分型号量产；整体开发阶段	自研运行功耗低极低、睡眠功耗低至 0.4 微安、唤醒时间短至 25 微秒的超低功耗芯片。	国内领先	消费电子、医疗电子领域

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，基于前述检查 2024 年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

本持续督导期内，公司存在募集资金使用进度与《招股说明书》所披露的计划不一致的情形，主要原因是公司募投项目均由若干子项目构成，而子项目需要在前期项目成果基础上面持续进行。各子项目成熟一个使用一个，分批投产使项目具有更高经济效益，项目延期符合募投项目研发的客观实际、公司整体利益和长远发展。保荐人已敦促上市公司重新论述相关募投项目的可行性，做好募投项目延期审议程序，并及时履行信息披露义务。公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目延期及增加实施主体的议案》。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况如下：

序号	姓名	任职	期末持股数量 (股)	年内减持数 量(股)	质押、冻结情 况
1	杨勇	董事长、核心技术 人员	126,000,000	-	无
2	周彦	董事、总经理	91,800,000	-	无
3	王继通	董事、副总经理	-	-	-
4	LIUZEYU	董事、副总经理	-	-	-

序号	姓名	任职	期末持股数量 (股)	年内减持数 量(股)	质押、冻结情 况
5	罗勇	董事	15,534,039	-	无
6	陈凯	董事	-	-	-
7	华金秋	独立董事	-	-	-
8	吴敬	独立董事	-	-	-
9	宋晓科	独立董事	-	-	-
10	蒋智勇	监事会主席	16,200,000	-	无
11	周飞	监事	13,500,000	-	无
12	冯超	职工代表监事	-	-	-
13	MIAOXIAOYU	副总经理、核心 技术人员	-	-	-
14	李振华	副总经理、核心 技术人员	450,000	-	无
15	吴新元	董事会秘书、财 务总监	-	-	-

注：杨勇直接持有公司 31.47%的股份，通过顺为芯华间接持有公司股份；王继通通过顺为芯华、顺为致远、重庆芯继间接持有公司股份；LIUZEYU 和 MIAOXIAOYU 通过顺为芯华间接持有公司股份；冯超通过顺为致远间接持有公司股份；李振华直接持有公司 0.11%股份，并通过顺为致远间接持有公司股份；吴新元通过顺为致远、重庆芯继间接持有公司股份。

除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在其他质押、冻结及减持情况。

十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中微半导体（深圳）股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人：

周鹏

王彬

中信证券股份有限公司

2025年4月18日